

CMI165[®]

带温度补偿功能的 面铜测厚仪

牛津仪器公司最新推出的**CMI165**，是世界首款带温度补偿功能的面铜测厚仪，手持式设计符合人体工学原理。

面铜测量的结果往往受到样品温度的影响。**CMI165**的温度补偿功能解决了这个问题，确保测量结果精确而不受铜箔温度的影响。这款多用途的手持式测厚仪配有探针防护罩，确保探针的耐用性，即使在恶劣的使用条件下也可以照常进行检测。

- 可测试高/低温的PCB铜箔
- 免去了试样成本
- 显示单位可为 μm , mils 或 oz
- 可在PCB钻孔、剪裁、电镀等工序前进行相关铜箔来料检验
- 可用于蚀刻或整平后的铜厚定量测试
- 可用于电镀铜后的面铜厚度测量



OXFORD
INSTRUMENTS

The Business of Science[®]

牛津仪器专利 检测探头SRP-T1

- SRP-T1探针可由客户自行替换，替换后无需再校准即可使用
- 备用的SRP-T1探头减少了用户设备的停工期
- 探针的照明功能有助于线型铜箔检测时的准确定位



操作界面有英文和简体中文两种语言供选择。



规格：

- 利用微电阻原理通过四针式探头进行铜厚测量，符合EN 14571 测试标准
- 厚度测量范围
 - 化学铜: (0.25-12.7) μm , (0.01-0.5) mils
 - 电镀铜: (2.0-254) μm , (0.1-10) mils
- 仪器再现性: $\sigma \approx 0.08 \mu\text{m}$ at 20 μm (0.003 mils at 0.79 mils)
- 强大的数据统计分析功能，包括数据记录、平均数、标准差和上下限提醒功能。
- 数据显示单位可选择mils、 μm 或oz
- 仪器的操作界面有英文和简体中文两种语言供选择
- 仪器无需特殊规格标准片，同样可实现蚀刻后的线型铜箔的厚度测量，可测线宽范围低至204 μm (8 mils)
- 仪器可以储存9690 条检测结果（测试日期时间可自行设定）
- 测试数据通过USB2.0 实现高速传输，也可保存为Excel格式文件
- 仪器为工厂预校准
- 客户可根据不同应用灵活设置仪器
- 用户可选择固定或连续测量模式
- 仪器使用普通AA电池供电



深圳市锦贤科技有限公司
SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.
电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934
网站: www.gene-sea.com
邮箱: genesea@126.com
Q Q: 510244122 32174454

OXFORD
INSTRUMENTS

The Business of Science®